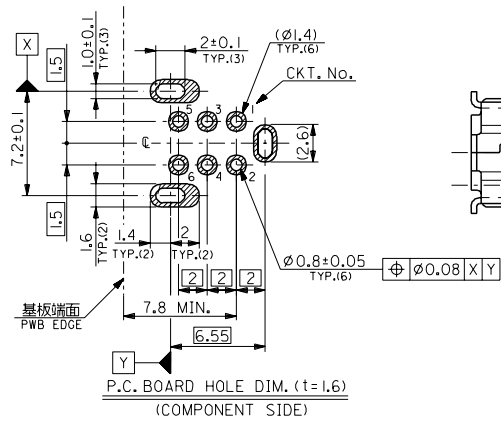
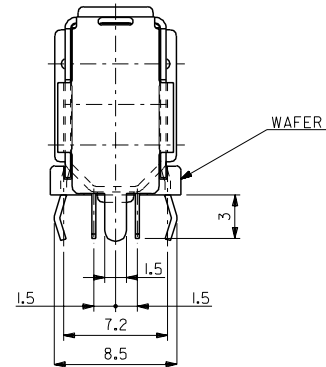
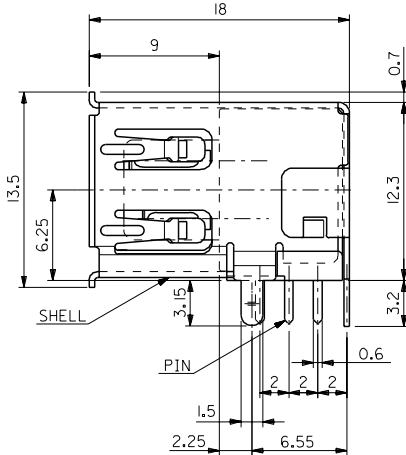
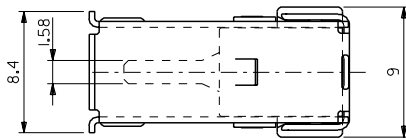
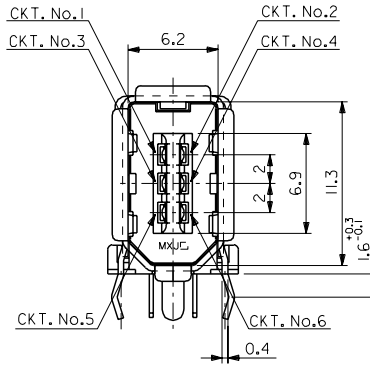




DWG. NO. SD-53460-0621

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



角度 ANGLE	+30
30 以上 OVER	+0.3
10 以上 30 未満	+0.25
10 未満	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	表参照 SEE TABLE
仕上げ FINISH	表参照 SEE TABLE
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
適用外径 INS. RANGE	—
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD
DR. CHK.	日付 DATE

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
2.0 I/O CONN. SOCKET RIGHT-ANGLE UPRIGHT WITH KINK	
DWG. NO.	REV
SD-53460-0621	A

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は日本モレックス(株)の所有する権利を有するもので当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

部品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	注記 NOTES
ウエハー WAFER	ガラス入り46ナイロン NYLON46 G.F.	G.F.30%, UL94V-0, 色:黒 G.F.30%, UL94V-0, COLOR:BLACK
ピン PIN	黄銅 t0.25 BRASS t0.25	接点部:金メッキ0.76µmMIN. CONTACT AREA:GOLD 0.76µmMIN. 半田付け部:半田メッキ3µmMIN. SOLDER TAIL AREA:TIN-LEAD 3µmMIN. 下地メッキ:ニッケルメッキ2µmMIN. UNDER-PLATING:NICKEL 2µmMIN.
シェル SHELL	りん青銅 t0.4 PHOSPHOR BRONZE t0.4	半田メッキ:3~6µm TIN-LEAD:3~6µm 下地メッキ:ニッケルメッキ1.27µmMIN. UNDER-PLATING:NICKEL 1.27µmMIN.

